

**第34回 RCJ信頼性シンポジウム
(EOS/ESD/EMCシンポジウム、
電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム)**

期日： 2024年11月7日(木)～11月8日(金)

会場： 大田区産業プラザ(東京 蒲田)

主催： 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター

発表論文投稿のお勧め

RCJ信頼性シンポジウムは、平成3年から開催し、微細化・高機能化が急進展している電子デバイス・電子部品の信頼性技術、静電気放電(ESD)対策技術を中心に発表・討論する場を、企業、大学、研究所の研究者・技術者の方々に提供すべき企画されました。厳しいESD・信頼性対策が要求されている微細化半導体デバイス、最新ナノテクノロジーデバイス、及びデバイス実装技術に焦点を当てています。

本年もさらに内容を充実すべく、各種企画を進めています。つきましては、皆様方に試験・研究成果の論文発表をして頂き、本シンポジウムの発展にご協力下さいますようお願い申し上げます。添付の発表論文募集の用紙(EOS/ESD/EMCシンポジウム、電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム)により、E-mail、FAX等で申込して下さいようお願い申し上げます。

シンポジウム内容

- 第34回 EOS/ESD/EMCシンポジウム
- 第34回 電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム

- 展示会： 同会場で、電子デバイス・装置の静電気対策・信頼性に焦点を当てた「信頼性・ESD 対策技術展示会」の同時開催を予定しています。

問い合わせ先

一般財団法人 日本電子部品信頼性センター RCJ信頼性シンポジウム事務局 (塩野、佐藤)
〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-6 カミナガビル 3階
TEL:03-5830-7601、FAX:03-5830-7602
E-Mail: shiono@rcj.or.jp HP: <https://rcj.or.jp/>

第34回 EOS/ESD/EMCシンポジウム発表論文募集

(主テーマ) 半導体デバイス・電子モジュール・電子装置等の過電圧(EOS)、静電気放電(ESD)、電磁環境両立性(EMC)試験方法、評価方法、誤動作対策事例及び対策用資材等

応募要領

- 論文の内容 : 上記の主テーマの他、半導体デバイス・電子モジュール、電子機器のEOS/ESD/EMC耐性向上技術、故障解析事例など
- 発表時間 : 原則として、討論を含めて1件25分
- 開催期日 : 2024年11月7日(木)～8日(金)
- 会場 : 東京都大田区産業プラザ(PIO)
京浜急行・空港線/京急蒲田駅より徒歩2分
JR京浜東北線/蒲田駅より徒歩12分
- 申込方法 : 下記の「発表論文申込書」の様式に所要事項を記入の上、お早めにお申し込み下さい。
- 申込締切 : 2024年7月5日(金)
- 発表論文原稿締切 : 2024年10月11日(金)
発表論文申込書の選考の結果、発表をご依頼することになった方には、7月下旬迄に原稿作成要領をお送りしますから期限内にご提出願います。
- 参加費 : 発表者からも参加費(5000円)を頂くことになりました。ご協力をお願いします。

申込先及び問い合わせ先

一般財団法人 日本電子部品信頼性センター RCJ信頼性シンポジウム事務局
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-6 カミナガビル3階
TEL:03-5830-7601、FAX:03-5830-7602、URL: <http://www.rcj.or.jp>

宛先 RCJ信頼性シンポジウム事務局宛 FAX: 03-5830-7602, E-mail: shiono@rcj.or.jp

第34回 EOS/ESD/EMCシンポジウム発表論文申込書

論文題名			分類(記入不要)	
和文:				
英文:				
発表者	氏名	和文:	TEL	
		英文:	FAX	
			E-mail	
	企業名			
	所属			
	所在地	〒		
発表内容				

第34回 電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム発表論文募集

(主テーマ) 先端部品・デバイスの故障物理、信頼性評価技術、故障解析技術、Pbフリーはんだ実装技術、KGD技術、マルチチップモジュール(MCM)の信頼性評価技術、等

応募要領

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 論文の内容 : 上記の主テーマの他、電子部品、半導体デバイス、及び電子機器の信頼性評価技術、故障解析事例など</p> <p>2. 発表時間 : 原則として、討論を含めて1件30分</p> <p>3. 開催期日 : 2024年11月7日(木)～8日(金)</p> <p>4. 会場 : 東京都大田区産業プラザ(PIO)
京浜急行・空港線/京急蒲田駅より徒歩2分
JR京浜東北線/蒲田駅より徒歩12分</p> | <p>5. 申込方法 : 下記の「発表論文申込書」の様式に所要事項を記入の上、お早めにお申し込み下さい。</p> <p>6. 申込締切 : 2024年7月5日(金)</p> <p>7. 発表論文原稿締切 : 2024年10月11日(金)
発表論文申込書の選考の結果、発表をご依頼することになった方には、7月下旬迄に原稿作成要領をお送りしますから期限内にご提出願います。</p> <p>8. 参加費 : 発表者からも参加費(5000円)を頂くことになりました。ご協力をお願いします。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

申込先及び問い合わせ先

一般財団法人 日本電子部品信頼性センター RCJ信頼性シンポジウム事務局
〒111-0043 東京都台東区駒形2-5-6 カミナガビル3階
TEL:03-5830-7601、FAX:03-5830-7602、URL: <http://www.rcj.or.jp>

宛先 RCJ信頼性シンポジウム事務局宛 FAX: 03-5830-7602, E-mail: shiono@rcj.or.jp

第34回 電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム発表論文申込書

論文題名		分類(記入不要)	
和文:			
英文:			
発表者	氏名	和文:	TEL
		英文:	FAX
			E-mail
	企業名		
	所属		
所在地	〒		
発表内容			